

**PCIM Europe 2026**  
**Toshiba Electronics Europe GmbH**  
**Halle 4A, Booth 4A-227**



**Toshiba präsentiert auf der PCIM Europe 2026 innovative Lösungen im Bereich der Leistungselektronik zur Förderung der Elektrifizierung**

SiC-Module der nächsten Generation, Hochleistungs-IEGT-Bauteile sowie von Experten geleitete Vorträge zur Steigerung von Effizienz, Leistungsdichte und Nachhaltigkeit in Schlüsselbranchen

**Düsseldorf, Deutschland, 28. Mai 2026** – Die Toshiba Electronics Europe GmbH präsentiert ihre neuesten Innovationen im Bereich der Leistungselektronik auf der PCIM Europe 2026 in Halle 4A, an Stand 4A-227, die vom 9. bis 11. Juni in Nürnberg, Deutschland, stattfinden wird. Getreu seiner Philosophie „*Excellence in Power*“ unterstützt Toshiba Techniker und Ingenieure in ganz Europa auch weiterhin mit robusten, leistungsstarken Lösungen, die die Effizienz, Leistungsdichte und Systemzuverlässigkeit steigern und so den Weg zu einer vollelektrischen Gesellschaft ebnen.

Mit seiner Präsenz auf der PCIM unterstreicht Toshiba den anhaltenden Fokus auf Leistungshalbleitern und den damit verbundenen Systemlösungen. Das Unternehmen hat sein Portfolio auf wichtige Anwendungsbereiche ausgerichtet. Es investiert weiterhin in Technologien, die den sich wandelnden Anforderungen in den Bereichen elektrifizierter Transport, Stromversorgungssysteme für die Industrie, erneuerbare Energieerzeugung, KI-gesteuerte Rechenzentren sowie der zukünftigen Gleichstromnetz-Infrastruktur gerecht werden.

Auf der Veranstaltung wird Toshiba seine neuesten Technologien vorstellen. Dazu gehören die SiC-MOSFET-Technologie der nächsten Generation und Module, die eine deutliche Reduzierung des Einschaltwiderstands und der Schaltverluste ermöglichen. Dadurch werden effizientere und kompaktere Hochfrequenz-Wechselrichtersysteme möglich. Die neuen Press-Pack-IEGT-Bauteile mit 6500 V/2000-A des Unternehmens sind

spezifisch für Hochspannungssysteme ausgelegt. Die wichtigsten Anwendungsbereiche dieser beiden Produkte sind Bahnantriebe, Stromnetze, die Schwerindustrie, Elektrofahrzeuge sowie Großanlagen für erneuerbare Energien und HLK-Systeme.

Besucher des Messestands haben die Möglichkeit, verschiedene unterstützende Technologien zu erkunden. Dazu gehören Referenzdesigns für Gate-Treiber, Isolation und Systemschutz für Hochspannungsanwendungen sowie komplette Demonstrationsplattformen für Wechselrichter, Motorsteuerungen und HLK-Anwendungen. Das Unternehmen wird außerdem seine auf SiC und Super-Junction-MOSFETs basierenden Stromversorgungslösungen für KI-Server, Schnellladegeräte und Telekommunikationsinfrastruktur vorstellen.

Toshiba wird darüber hinaus Einblicke in fortschrittliche Verpackungskonzepte, Wafer, Bare-Dies und Modul-Mock-ups für Automobilanwendungen geben. Ergänzt werden diese durch Rapid-Prototyping-Lösungen unter Verwendung von Software-Tools und MIKROE Click Boards™. Ebenfalls vorgestellt werden einsatzbereite BLDC-/DC-Motortreiber und Gate-Treiber für die Automobilbranche, die mit und ohne MCUs erhältlich sind.

„Von vielen der Systeme, die unsere Kunden entwickeln, wird erwartet, dass sie über lange Lebenszyklen hinweg zuverlässig funktionieren“, erläutert Matthias Diephaus, General Manager für Halbleiter-Produktmarketing bei der Toshiba Electronics Europe GmbH. Unser Ansatz besteht darin, stabile Bauteil-Plattformen und klare Produkt-Roadmaps bereitzustellen sowie den technischen Support zu bieten, der für deren effektive Umsetzung erforderlich ist. Laufende Investitionen in die Fertigung und die Zusammenarbeit unterstützen dieses Ziel.“

Neben der Präsenz auf der Messe werden Toshiba-Experten mit mehreren Fachvorträgen zum PCIM-Konferenzprogramm beitragen:

- **[Erhöhung der Leistungsdichte von Netzteilen für KI-Server oder Ladegeräte mit SMD-SiC-MOSFETs](#)**  
*Mittwoch, den 10. Juni 2026 | 15:50 Uhr | Ausstellerbühne, Halle 4A, 320*
- **[6500-V-Klasse-PPI mit Trench-IGBTs der 2. Generation](#)**  
*Donnerstag, den 11. Juni 2026 | 10:10 Uhr | Bühne: Istanbul, Ebene 2 (IGBT-Technologien)*
- **[Effizienter Hochfrequenz-Wechselrichterbetrieb von Leistungsmodulen mit fortschrittlichen SBD-integrierten SiC-MOSFETs](#)**  
*Donnerstag, den 11. Juni 2026 | 15:00 Uhr | Bühne: St. Petersburg, Ebene 2 (SiC-MOSFETs II)*

Die Toshiba-Experten stehen Ihnen während der gesamten Veranstaltung zur Verfügung, um zu erörtern, wie diese Technologien das Design von Stromversorgungssystemen der nächsten Generation unterstützen können.

Weitere Informationen finden Sie unter: [https://toshiba.semicon-storage.com/eu/company/exhibition/articles/exhibition\\_PCIM2026.html](https://toshiba.semicon-storage.com/eu/company/exhibition/articles/exhibition_PCIM2026.html)

###

## **Über Toshiba Electronics Europe**

[Toshiba Electronics Europe GmbH](#) (TEE) bietet Verbrauchern und Unternehmen in Europa eine große Auswahl an Festplattenlaufwerken (HDDs) sowie Halbleiterlösungen für Anwendungen in den Bereichen Automotive, Industrie, IoT, Bewegungssteuerung, Telekommunikation, Netzwerke, Consumer und Haushaltsgeräte. Neben HDDs umfasst das Angebot auch Leistungshalbleiter und andere diskrete Bauelemente von Dioden bis hin zu Logik-ICs, Optoelektronik sowie Mikrocontrollern/MCUs und anwendungsspezifischen Standardprodukten (ASSPs). Darüber hinaus bietet TEE auch SCiB™-Batteriezellen und -Module mit Lithium-Titan-Oxid (LTO) für Hochleistungsanwendungen.

TEE hat seinen Hauptsitz in Düsseldorf, Deutschland, und verfügt über Niederlassungen in Frankreich, Italien, Spanien, Schweden und Großbritannien, die Marketing-, Vertriebs- und Logistikdienstleistungen anbieten.

Weitere Unternehmens- und Produktinformationen finden sich auf den Websites von Toshiba unter [www.toshiba.semicon-storage.com](http://www.toshiba.semicon-storage.com) und [www.scib.jp/en](http://www.scib.jp/en).

## **Ansprechpartner für Veröffentlichungen:**

Toshiba Electronics Europe GmbH, Hansaallee 181, D-40549 Düsseldorf, Deutschland  
Tel: +49 (0) 211 5296 0  
Web: [www.toshiba.semicon-storage.com/eu/company/news.html](http://www.toshiba.semicon-storage.com/eu/company/news.html)

## **Ansprechpartner für die Presse:**

Michelle Shrimpton, Toshiba Electronics Europe GmbH  
Tel: +44 (0)7464 493526  
E-Mail: [MShrimpton@teu.toshiba.de](mailto:MShrimpton@teu.toshiba.de)

## **Herausgegeben durch:**

Birgit Schöniger, Pretzl  
Tel: +49 (0)172 617 8431  
Web: [www.pretzl.com](http://www.pretzl.com)  
E-Mail: [birgit.schoeniger@pretzl.com](mailto:birgit.schoeniger@pretzl.com)